

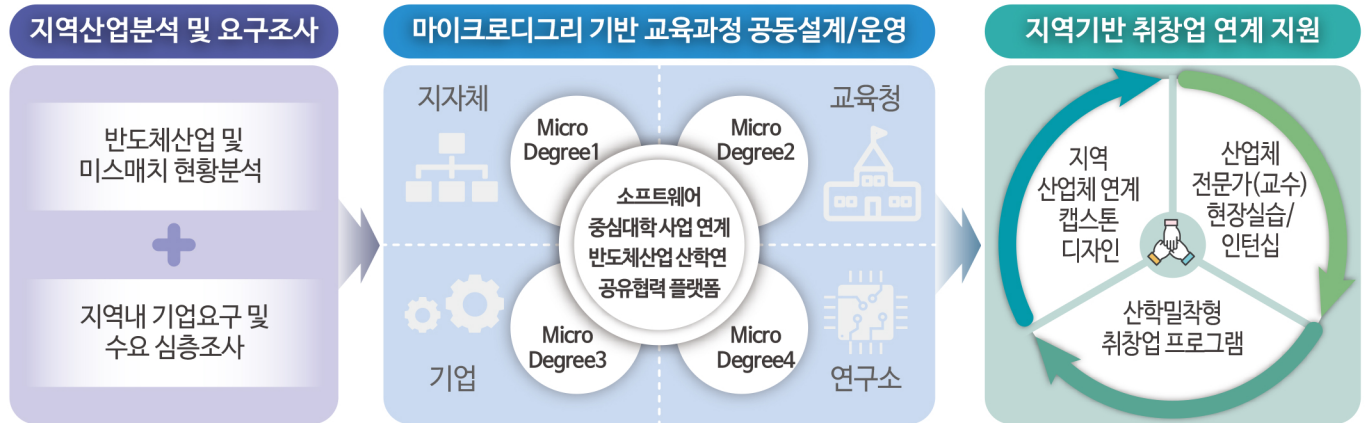
우송대학교 차세대 반도체/SW 설계 교육과정

교육목표

- 지역 산업체와 교육과정 공동 개발·운영 및 취업 연계를 통한 미스매치 분야의 반도체산업인력 전문인력 양성

교육과정 구성

- 요구조사** 참여기업 수요 조사 및 focus group interview를 통해 미스매치 인력 분석
- 공동설계·운영** 지역산업 연계 쌍방향 공유협력 플랫폼을 통해 수요자 중심 교육과정 및 산학공동기술개발 지원
소프트웨어 중심대학 사업과 연계하여 SW설계 특성화 및 반도체 HW 지원
- 취창업연계** 산업체 기업 연계형 캡스톤디자인 구성 + 산업체 전문가(교수) 중심의 현장실습/인턴십 운영
+ 산학 밀착형 단계별 취창업 프로그램으로 취창업역량 강화



교육일정 및 세부과정

- 교육일정** 2022. 9월 ~ 2023. 6월 교육시행 후 취업연계 (1년 교육과정)

과정	내용	과정	내용
MD1 (Micro Degree) : 회로/논리	회로이론/실습 - SPICE 시뮬레이션 - 회로이론(3)/실습(2)	반도체회로/실습(심화과정)	- PSIM 시뮬레이션 - PCB 설계 및 응용 - 반도체회로(3)/실습(2)
	논리회로/실습 - 논리회로(3)/실습(2) - FPGA 구현 및 시뮬레이션	반도체 소자/공정(심화과정)	- TCAD 공정/소자 시뮬레이터를 이용한 반도체 공정 능력 배양 - 반도체소자(3)/공정(2)
MD3 (Micro Degree) : 응용 및 설계기초	반도체 응용 I - 알고리즘 코딩, 아두이노 - MCU프로그래밍, PCB설계 및 반도체 보드구현	반도체응용 II (심화과정)	- PCB 설계 및 보드 구현 - MCU, FPGA 적용 시스템 보드 - IoT 응용회로
	반도체 설계 I - 소자급 부품 설계 및 시뮬레이션 - Wafer Probing	반도체 설계 II (심화과정)	- 시스템 IC 회로 설계 - 레이아웃 설계, MPW 칩 구현 - Wafer Probing
		MD2 (Micro Degree) : 회로/소자	
		MD4 (Micro Degree) : 응용 및 설계심화	